

信頼性試験結果 Reliability Test

XCL248 シリーズ

XCL248 Series

パッケージ

DFN3030-10B

RoHS対応品 / RoHS Compliance

Package

ハロゲン&アンチモンフリー / Halogen & Antimony-Free

IC部 / IC

No.	試験項目 Test Item	試験条件 Test Conditions		時間 Hours	試験結果 Result (r/n)
1	高温バイアス High Temperature Bias	150°C VIN=37.8V		1000	0/22
2	高温保存 High Temperature Storage	150°C		1000	0/22
3	温度サイクル Temperature Cycle	-65°C~150°C 各30分 30min. each		100CYC.	0/22
4	プレッシャークーカーバイアス HAST	130°C85%RH 2×10 ⁵ Pa, VIN=37.8V, FB=1.0V, PG=5.25V		100	0/22
5	はんだ耐熱 Resistance to Soldering Heat	85°C85%RH168h→reflow(150~200°C140sec/255°C30sec/260°C10sec)3times Moisture Sensitivity Level 1 Based on IPC/JEDEC J-STD-020		-	0/11
6	静電耐圧 Electric Static Discharge	MM	R=0Ω C=200pF ±200V	3回 3 times	0/5
		HBM	R=1500Ω C=100pF ±1kV	3回 3 times	0/5
		CDM	±500V	3回 3 times	0/5
7	ラッチアップ Latch-Up	E-test	VIN=54V Pulse Voltage	1回 1 time	0/5
		I-test	±100mA	1回 1 time	0/5

コイル部 / Coil

No.	試験項目 Test Item	試験条件 Test Conditions		時間 Hours	試験結果 Result (r/n)
1	高温バイアス High Temperature Bias	125°C IDC=1.5A		1000	0/77
2	高温保存 High Temperature Storage	125°C		1000	0/77
3	高温高湿保存 Temperature Humidity Storage	85°C85%RH		1000	0/77
4	温度サイクル Temperature Cycle (Gaseous)	-40°C~125°C 各30分 30min. each		1000CYC.	0/77

パッケージ代表データ

Performed with samples that represent the applicable PKG type.

No.	試験項目 Test Item	試験条件 Test Conditions		試験結果 Result (r/n)
1	接合強度試験 Adhesive strength test	PKG側面を10N 10秒間加圧する (EIAJ ED7403) Apply a pressure of 10N on the side face of the PKG for 10sec.		0/5
2	基板反り試験 Bending Test	たわみ量 5mm 5±1s 1回/1time (EIAJ ED4702) Strain		0/5
3	はんだ付け性 Solderability	230°C10秒 (プロファイル昇温法) 230°C10s (Temperature profile method)		0/11